

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成23年12月1日(2011.12.1)

【公表番号】特表2011-503784(P2011-503784A)

【公表日】平成23年1月27日(2011.1.27)

【年通号数】公開・登録公報2011-004

【出願番号】特願2010-532120(P2010-532120)

【国際特許分類】

H 01 B 9/02 (2006.01)

H 01 B 3/44 (2006.01)

B 32 B 27/18 (2006.01)

B 32 B 7/02 (2006.01)

【F I】

H 01 B 9/02 A

H 01 B 9/02 B

H 01 B 3/44 P

B 32 B 27/18 J

B 32 B 7/02 104

【手続補正書】

【提出日】平成23年10月12日(2011.10.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1の高分子樹脂および導電性充填剤を含む第1の材料を含む半導体層；および

第2の高分子樹脂を含む第2の材料を含む絶縁層を含む、構造体であって、

半導体層および絶縁層は少なくとも部分的に互いに物理的に接触しており、

第1の材料および第2の材料の少なくとも1つは有機粘土を含み、第1の高分子樹脂および第2の高分子樹脂は同一であっても異なっていてもよく、

有機粘土を欠くという点を除いて前記構造体と同一である比較構造体と前記構造体とのAC誘電損失の比が1.5を超える、構造体。

【請求項2】

有機粘土が、第1の材料および/または第2の材料中のいずれかに、前記材料中の高分子樹脂の全重量に対して最大約3重量%の量で存在する、請求項1に記載の構造体。

【請求項3】

有機粘土が、第四級アンモニウム化合物で改質された天然モンモリロナイトである、請求項1に記載の構造体。

【請求項4】

熱可塑性樹脂が少なくとも1つのエチレンホモポリマーおよび/またはエチレンコポリマーを含む、請求項1に記載の構造体。

【請求項5】

前記熱可塑性樹脂が、少なくとも1つのプロピレンホモポリマーおよび/またはプロピレンコポリマーを含む、請求項1に記載の構造体。